

CIRCULAR No, 007-DGAC-2019

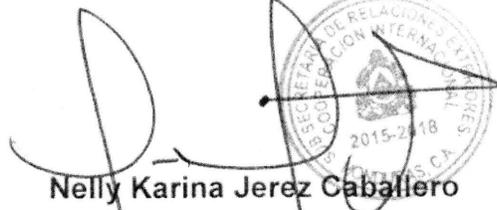
Tegucigalpa, M.DC., 07 de febrero de 2019

SEÑORES CONSULES, CONSULES GENERALES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en ocasión de remitirles información relacionada con el lanzamiento de la "**HONDUEXPO 2019: EMPAQUE Y DISEÑO**", evento organizado por la Secretaria de Desarrollo Económico que se llevará a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula, los días 2,3 y 4 de abril del año en curso, este evento está dirigido a las empresas de diseño y empaquetado, específicamente, para los sectores de frutas y vegetales frescos, productos farmacéuticos, bebidas café, alimentos procesados, snacks y confitería, productos textiles y prendas de vestir etc.

Dicha información se remite para que sea publicado en las redes sociales de esas Oficinas Consulares.

Distinguida Consideración.


Nelly Karina Jerez Caballero
Subsecretaria de Estado



cc. Archivo.